

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部成分表製品名(鉛フリー): XC61HxxxxxMR-G
標準質量: 14 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.528	シリコン	37700	7440-21-3
リードフレーム	3.553	銅	253800	7440-50-8
	0.011	錫	800	7440-31-5
	0.006	亜鉛	400	7440-66-6
	0.011	クロム	800	7440-47-3
	0.159	銀	11300	7440-22-4
ダイアタッチ	0.040	銀	2900	7440-22-4
	0.007	エポキシ	500	—
ボンディングワイヤ	0.030	金	2100	7440-57-5
封止樹脂	7.687	溶融シリカ	549000	60676-86-0
	0.718	エポキシ樹脂	51300	—
	0.614	フェノール樹脂	43900	—
	0.436	金属水酸化物	31200	—
端子メッキ	0.200	錫	14300	7440-31-5

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。